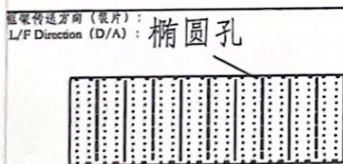
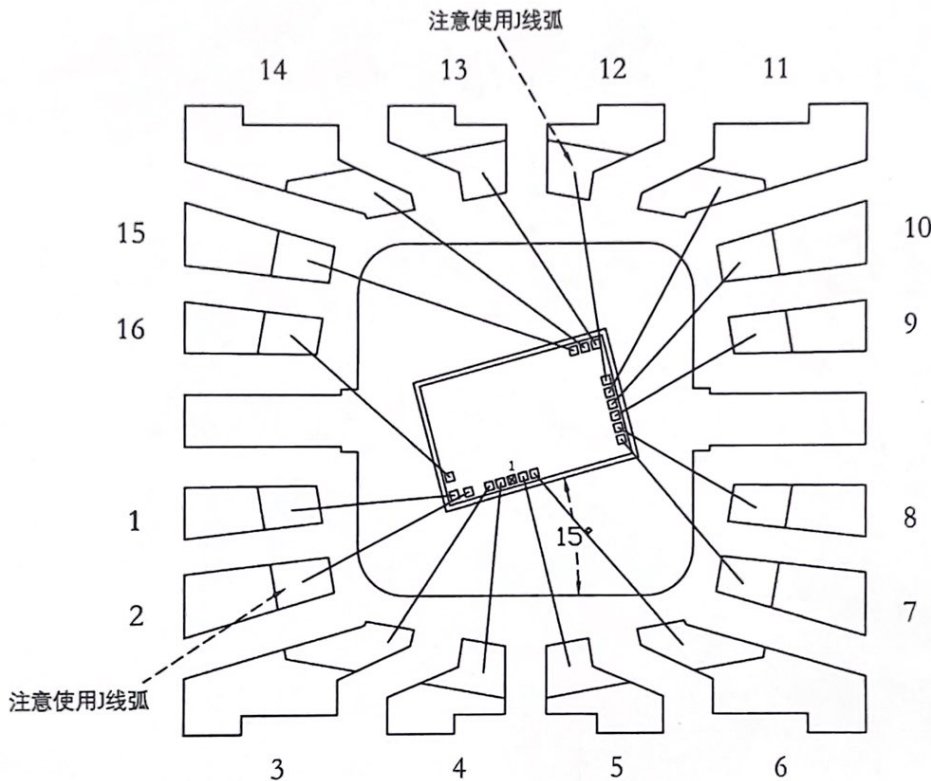


池州华宇电子科技股份有限公司 CHI ZHOU HUYU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD				客户代码 Customer No.	008	线号 Drawing No.	HY-PX-008-747 A	
焊线图 Bonding Diagram				产品名称 Product Type	HS5146_M2		封装外型 PKG Type	SOP16L(12R)
焊线种类 Wire Type	焊线直径(μm) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm) Shortest wire length	塑料料号(绿色环保) Compound Type (Green)	LF 载体尺寸 LF Pad Size	
合金丝 Ag	20	16	22791	1685	970	优选(Preferrd): EME-G630AY 备选(Optional): CEL-17021F	SOP16L-12R (80*80mil) 2032*2032(μm <sup>2</sup> )	
客户图号 Customer drawing NO.								



注意: 基岛全镀银

实物图:  
Chip photo:

特殊说明 Special Instructions:

DB注意:  
1. 芯片居中放置并逆时针旋转15°;  
WB注意:  
1. 数字为不打线pad点个数。

说明 Remarks	贴片胶类型 Epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BPP(μm <sup>2</sup> )	最小焊盘间距 Min BPP(μm)	铜垫厚度(μm) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	划片线宽度 Street line (μm)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否处 Lead (mm)	载带厚度 (mm)
A芯: DIE A	导电胶 (conductive) S210	DB3	1150*709(μm <sup>2</sup> ) 45.28*27.91(mil <sup>2</sup> )	50*50	70	2	是/Yes	60	8	否/NO	300
B芯: DIE B											
C芯: DIE C											
编制 Prepared by	刘梅梅, 2024.4.15		制图日期 Create Date	2024/4/25		生效日期 Effective Date	客户确认签字/盖章: 刘梅梅 2024.04.26				
研发审核 R&D Check	2024.4.25		产品工程审核 PE Check			批准 Approved by					

\*温馨提示: 图纸为产品下线生产唯一依据, 请认真确认, 我司依据您签字后的图纸生产, 如因图纸错误产生不可谓量损失, 谢谢!  
\*Warm tip: the drawing is the only basis for the production of the product. Please confirm it carefully. Our company will produce the drawings according to the drawings you have signed back, such as drawing mistakes, which will produce incalculable loss. Thank you!